

技術資料

FeedBond®FP-5023-E2

導電銀膠

產品說明：

FeedBond®FP-5023-A2 為單液型環氧樹脂導電銀膠接著劑，專為中小型 IC 封裝晶片黏著應用所設計。適用於銀鍍層、金鍍層以及銅製導線框的黏著。

產品特徵：

- 平滑、流體且不拉絲之銀膠。
- 測試金、銀及銅材質不溢膠。
- 對於不同的材質皆有良好之接著性。
- 低應力。

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	銀灰色	Brookfield DV-Ⅲ/CP-51 @ 5rpm Brookfield DV-Ⅲ/CP-51 黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm 細度計 黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P006
黏度 @ 25℃	9,500 cps		FT-P008
搖變指數	3.5		FT-P026
@ 25℃			FT-P002
細度	< 20 μ m		FT-P024
含水率	< 0.5%		FT-P018
使用壽命 @ 25℃	48 小時		
保存期限 @ -40℃	12 個月		
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		20~30 分鐘升溫至 150℃，並在 150℃持溫 60 分鐘。(烘箱烘烤)	
其他烘烤條件		20~30 分鐘升溫至 175℃，並在 175℃持溫 30 分鐘。(烘箱烘烤)	

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

FeedBond® FP-5023-E2

物理及化學性質	測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg) 63°C	TMA	FT-M016A
玻璃轉移溫度 (Tg) 92°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M019A
熱膨脹係數 < Tg 52 ppm/°C > Tg 212 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數 @60°C 5156MPa @25°C 3978MPa @150°C 93MPa @250°C 89MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
熱重損失@300°C < 1 %	Thermogravimetric Analysis	FT-P010
離子含量 Cl ⁻ < 20 ppm Na ⁺ < 10 ppm K ⁺ < 10ppm	Teflon flask, 20~40 mesh, 5g sample in 50g DI water, 24hr@100°C	FTC-021
機械性質	測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C 10 kg/die @150°C 2 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (銀/銅支架)	FT-M012
熱/電性質	測試條件	測試方法
熱傳導係數@ 25°C 2 W/m-K	Hot Disk	FT-P022
體積電阻 0.0001Ω-cm	四點探針	FT-P017

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間30-90鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）。